



2023 達興材料研究生獎學金施行辦法

一、關於達興材料研究生獎學金：

達興材料重視研發人才培育，並善盡企業回饋之責任。為促進台灣高等科技教育的永續發展，培養未來化學材料產業關鍵人才，設立「達興材料研究生獎學金」，鼓勵台灣化學/化工/材料及理工相關領域博士、碩士在學之全職研究生，能秉持創新熱忱，持續深耕科學研究。

二、申請對象：

具中華民國國籍，正就讀於臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學之化學/化工/材料及理工相關領域之博士（包含已取得資格且預計入學者）、碩士在學生；或於上述系所畢業，目前正於海外攻讀研究所之在學研究生。

三、申請資格：

1. 112 學年在學之博士、碩士全職研究生。
2. 大學畢業總成績平均 GPA 3.7/4.3 以上。
3. 未受領其他有服務義務之獎助學金者。例如：畢業後需至公司任職綁約之相關條件交換...等。

四、獎助內容：

1. 獎學金名額：共六名，不足額可從缺。
2. 獎學金金額：博士生獎學金每位新台幣 24 萬元，碩士生獎學金每位新台幣 12 萬元，一次性發放。
3. 其他獎助內容(非強制性義務)：
 - (1) 得主可自由選擇在學期間參與達興實習、企業參訪，若畢業後欲加入達興將優先任用。
 - (2) 提供業師資源，協助了解產業、技術發展階段與挑戰。

五、申請方式

1. 時間：請於2023年8月31日(四)前完成投件。
2. 方式：請至下方路徑登入google帳號填寫線上申請表，並上傳下列文件各一份：

<https://forms.gle/sqAW2ZrheB2Mczik8>

- (1) 大學(含)以上之各學年中文成績單，海外學歷可提供英文成績單 (含名次證明，若獲得書卷獎請檢附證明)。
- (2) 研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作摘要 (以10頁為限)：
 - a. 博士生請上傳附件1.1，碩士生請上傳附件1.2。
 - b. 以國際期刊、研討會之學術論文或專利尤佳；提出、審核中或已通過者均可。
- (3) 履歷/自傳 (格式不限)。
- (4) 研究計畫 (以10頁為限)。
- (5) 獎學金申請人承諾書 (附件2親筆簽名，掃描後上傳)。

未依申請規定填寫申請文件、申請文件不全、提供不正確資料，或逾期未完成申請作業者，恕不受理。

六、審核標準及程序：

1. 第一階段書面審查：申請人於申請期限內繳交，且資料齊全，得進入資格審查程序。
2. 第二階段面試審查：通過第一階段審查者，將邀約參加面試審查，相關資訊另行通知。
3. 結果公告：獲獎名單於2023年12月公告於達興官方網站，本公司將邀請獲獎同學與指導教授一同至公司參與獎學金頒獎典禮及公司參訪。

七、注意事項：

1. 主辦單位保留變更、修改、審查、退件之權利。
2. 獎助期間以一學年為單位，獲獎學生於受獎期間須維持全職學生身分，並不得同時領取其他有約定附帶服務義務之獎學金(例如：畢業後需至公司任職綁約之相關條件交換...等)，若有疑慮，應於申請前向承辦人確認。違反本條約定者，達興材料有權取消該名學生獲獎資格，終止其受領本獎學金之資格，如已領取，願退還已領取之獎學金。由政府機關及非營利性質財團法人捐助用於學術合作性質之獎助學金不在此限。



八、關於達興材料

達興材料為特用化學材料研發設計製造公司，我們重視基礎科學、多元人才及紮實的核心技術，從「Design House」材料設計出發，結合先進製程及設備開發技術，同步發展「Advanced Foundry」，提供難以取代的關鍵材料及客製化的解決方案。自2006年7月成立以來，我們秉持創新、企圖心及永續精神，致力成為世界頂尖的材料創新者！

- 最新職缺請參閱 104：<https://www.104.com.tw/company/d0z38kg>
- 更多達興人生活在 Instagram：<https://www.instagram.com/daxinmat/>
- Daxin Career Line 官方帳號 @daxinmat

九、聯繫窗口

達興材料股份有限公司 獎學金專案小組 家禎

Tel：04-24608889 #7469 / E-mail：Recruiting@daxinmat.com

【博士生】研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表

SCI 期刊論文						
NO.	期刊名	impact factor	論文名稱	作者序	出版年	狀態 (註 1)

專利			
NO.	申請號	專利名稱	獲證 (Y/N)

註 1: 請填寫發表狀態，例如：Published, Under review, ...

註 2: 表格如不敷使用，請自行增列填寫。

註 3: 請將列表中之論文資料編號並附於此表後，以利審查。

【碩士生】研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表

SCI 期刊論文						
NO.	期刊名	impact factor	論文名稱	作者序	出版年	狀態 (註 1)

專利			
NO.	申請號	專利名稱	獲證 (Y/N)

專題			
NO.	專題名稱	指導老師	完成年

註 1: 請填寫發表狀態，例如：Published；Under review...

註 2: 表格如不敷使用，請自行增列填寫。

註 3: 請將列表中之論文資料編號並附於此表後，以利審查。

獎學金申請人承諾書

本人_____為參加達興材料研究生獎學金，同意提供本人個人資料(包含申請後隨時依達興材料之通知，提供獎學金申請所需之相關文件或資訊)，供達興材料基於獎學金申請之目的蒐集、處理及利用，並同意資料建檔於達興材料人才資料庫，且遵守以下規定：

1. 本人已詳讀且承諾遵守達興材料研究生獎學金施行辦法各項說明。
2. 本人承諾所提供之個人資料為真實、完整且符合達興材料研究生獎學金要求。
3. 本人未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金，若經查證與事實不符，本人同意放棄達興材料研究生獎學金之領取資格，如已領取，願退還已領取之獎學金。

達興材料之蒐集、處理及利用本人個人資料應遵循個人資料保護法及相關法令之規範，且本人有權就自身個人資料行使以下權利：(1)請求查詢或閱覽。(2)製給複製本。(3)請求補充或更正。(4)請求停止蒐集、處理及利用。(5)請求刪除。

此致 達興材料股份有限公司

立書人(中文正楷簽名)：

身分證字號：

通訊地址：

中 華 民 國 年 月 日